



앰코는 멀티 애플리케이션을 위한 광학 패키지 솔루션을 제공합니다

2018 년 12 월 13 일, 아리조나주 템피 — 반도체 패키징 및 테스트 아웃소싱 분야의 선두업체인 앰코테크놀로지(Amkor Technology, Inc.)는 최근 성장하고 있는 광학 기기 시장에 대응하기 위해 멤스(MEMS)와 센서 패키지 플랫폼을 확장한다고 발표했습니다. 새로운 광학 패키지 플랫폼은 ChipArray® BGA (CABGA)와 MicroLeadFrame® (MLF) 제품군이며, 라이다 (LIDAR, 빛을 이용해 물체를 감지하고 거리를 측정하는 기술), 지문인식, 주변광 센서(ALS), 3D 안면인식 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.

앰코테크놀로지의 John Donaghey 전무이사는 "앰코는 25 년간 오토모티브, 커뮤니케이션, 소비자 애플리케이션용 멤스 및 센서 디바이스를 제조하고 테스트한 경험을 보유하고 있다."면서, "앰코는 광학 기기 시장의 요구사항을 해결하기 위해 대용량 멤스 및 센서 패키지 플랫폼을 확장하게 되었고, 이를 통해 고객에게 성능 저하 없이 신속하게 솔루션을 제공할 수 있다."고 언급했습니다.

앰코의 각 사업장들은 IATF16949 국제자동차품질경영시스템규격 인증을 받았으며, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격인 AEC-Q100 의 엄격한 기준을 충족하고 있습니다. 앰코의 풀 턴키 광학 멤스 및 센서 솔루션에는 설계, 패키징 및 테스트가 포함됩니다. 광학 멤스 및 센서 패키징 분야에 대한 자세한 내용은 홈페이지(www.amkor.com/technology/optical-sensors/)에서도 볼 수 있습니다.

Amkor Technology, Inc.

앰코테크놀로지코리아(Amkor Technology, Inc.)는 반도체 패키징 및 테스트 분야에서 세계 최대 아웃소싱 기업 중 하나이며 세계 시장을 선도하고 있습니다. 1968 년 설립된 앰코는 지속적으로 개선과 성장, 혁신을 추구해 왔으며, 현재 250 여 곳이 넘는 세계 유수의 반도체 기업들과 전략적으로 긴밀한 파트너십을 유지하고 있습니다. 반도체 패키징 제조 분야에서의 독보적인 전문성과 반도체 업계가 직면한 과제를 해결하는 기술력은 앰코의 큰 강점입니다. 자세한 내용은 www.amkor.com 를 참고하십시오.

**Keywords**

OSAT

Semiconductor packaging

Advanced IC packaging

Assembly and test

Optical sensor packaging

Optical sensor test

Heterogenous integration

MEMS

MOEMS

Sensors

BGA

ChipArray®

MicroLeadFrame®

ContactsInvestor Relations

Chris Chaney

Vice President, Investor Relations

480-786-7594

Media Relations

Debi Polo

Senior Manager, Marketing Communications

480-786-7653

Social Media: @amkortechology